

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 永赢基金、润晖投资、汇添富资管、Dymon Asia、Goldman Sachs AM、Greenwoods、JPM AM、Janchor Partners、Keystone Investors、Marshall Wace、Millennium Capital、UG Funds、WT Asset、砺思资本、万家基金、从容投资、水璞私募、瀛赐私募、东吴基金、东方基金、东方资管、东方阿尔法、中交资本、中信证券、中信银行、中加基金、中国人民养老保险、中安汇富、中欧基金、中邮基金、中金资管、中银基金、中银理财、交银施罗德基金、人保资产、人寿养老保险、仙人掌私募基金、众安保险、保银资产、光大保德信基金、兴业基金、兴证全球基金、农银汇理、创金合信基金、前海人寿保险、前海开源基金、华商基金、华夏久盈资产、华夏基金、华安基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、华能贵诚信托、南方基金、博时基金、博道基金、君成投资、和洋资产、和谐汇一资管、嘉实基金、国任财险、国信证券、国投瑞银基金、国投证券、国泰基金、国联安基金、国金基金、大家资产、大成基金、天弘基金、太平养老保险、太平基金、太平资产、姚泾河私募基金、安信基金、安联基金、宏利基金、宝盈基金、宽格 </p>

	<p>投资、富国基金、富达价值、工银瑞信、工银资管、平安养老保险、平安基金、平安资产、广发基金、广发证券、广发资管、建信养老保险、建信基金、彤心雕琢私募基金、彤源投资、德华创业投资、德邦基金、恒越基金、成泉资本、招商信诺资管、招商基金、招银理财、摩根士丹利基金、敦和资产、新华基金、新华资产、方正富邦基金、易方达基金、景顺长城基金、望正资产、朱雀基金、乐信投资、杭银理财、民生理财、汐泰投资、泉果基金、泓德基金、泓澄投资、泰康资产、浦泓私募、浦银安盛基金、海富通基金、海辉华盛、涡流私募、淡水泉资产、混沌投资、清和泉资本、渊泓投资、源乘投资、玄元投资、瓴仁投资、申万菱信基金、白犀私募、百年保险资管、益恒投资、盘京投资、睿扬投资、睿远基金、碧云资本、磐泽资产、第一创业证券、红筹投资、聚鸣投资、英睿投资、茗晖基金、融通基金、诺安基金、诺德基金、财通资管、趣时资产、远信投资、重阳投资、金鹰基金、鑫巢资本、银华基金、银河基金、长信基金、长城财富保险资管、长江养老保险、长江资管、阳光资管、青骊投资、高毅资产、高瓴资本、鹏华基金、博裕资本、大和证券、Tekne Capital、Oxbow Capital、Grand Alliance AM、中金公司等 370 位机构投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2026年05月11日-2026年05月15日</p>
<p>地点</p>	<p>深圳、杭州、胜宏科技惠州总部</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、董事、总裁：赵启祥 2、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶 3、投资者关系经理：王慧珍 4、投资者关系专员：汤佳怡</p>
<p>投资者关系活动主要内容</p>	<p>一、公司发展情况介绍</p> <p>1、AI 带来的行业机遇</p> <p>AI 工业革命的兴起，推动算力相关下游领域高速发</p>

<p>介绍</p>	<p>展。未来五年，在人工智能的引领下，服务器/数据储存、网络通信、汽车电子等下游行业需求将持续增长，带动高多层板、HDI 板保持较高增长。根据 PrismaMark 数据，AI 服务器相关 PCB 市场 2024—2029 年年均复合增速将达到 18.7%；其中，AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速为 29.6%，AI 相关 18 层及以上多层板年均复合增长率为 33.8%，远远超过 PCB 行业平均增速。</p> <p>公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”，精准把握 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，持续巩固在全球 PCB 制造领域的技术领先地位。在 AI 算力、数据中心、高性能计算等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比显著提升，推动公司业绩高速增长。</p> <p>2、公司领先优势</p> <p>(1) 战略优势</p> <p>公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”的核心发展理念，紧抓 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，成功抢占市场先机。未来，公司将继续紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，与客户共成长，把握未来技术和产品风向，为客户提供更优的技术和更好的品质服务，不断提升核心竞争力。</p> <p>(2) 技术优势</p> <p>公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期。公司具备 100 层以上高多层 PCB、10 阶 30 层 HDI 与 16 层任意互联(Any-layer)HDI 的技术能力，并积极推进下一代 14 阶 36 层 HDI 的研发认证；公司的 AI 算力卡、AI Data Center UBB& 交换机市场份额全球领先。</p>
-----------	--

(3) 品质优势

公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业较高水平。AI 技术在全流程各检测站分别实现全覆盖，可自动判别、自动筛选、自动统计、自动分析，确保不良品零流出。通过 AI 历史数据建档，精准分析高频问题发生环节，推动产品不良持续改善，实现零缺陷生产目标。

(4) 产能优势

公司现有产能涵盖广东、湖南、泰国、马来西亚等多个地区，其中，惠州总部已成为全球规模最大的单体 PCB 生产基地，全球化交付、服务能力行业领先。未来，随着惠州工厂、泰国工厂、越南工厂和马来西亚工厂等项目陆续投产爬坡，公司的高端产品产能将进一步提高，能够更好地满足客户全球化交付需求。

(5) 客户优势

凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，与众多国内外科技巨头公司深度合作，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲，构建了深厚的护城河。

(6) 管理层及文化优势

公司创始人兼董事长陈涛先生是 PCB 行业公认的技术专家和领导者，带领公司精准把握产业趋势，深挖下游行业需求迭代趋势，推动公司高速发展。在董事长的带领下，公司组建了一支具备强大技术专长，经验丰富，兼具国际视野的高级管理团队。同时，公司坚持人才驱动战略，构建全球化人才引进与培养体系，围绕 AI 算力等核心领

域定向引进高端管理及技术人才。

3、下游供需格局

从整个供需结构上看，行业对高端产能的需求持续增加，高端产品的供给仍然处于相对紧张的状态。公司同时在研发方面进行多客户的适配，这一适配有利于公司未来进行客户和订单的选择，公司会考虑订单规模、确定性程度、盈利能力等因素进行产能分配。

4、PCB 未来发展趋势

在 AI 领域，随着算力需求持续提升，行业发展趋势是不断降低单位算力能耗、提升算力密度和电性能能力，具体体现为：信号传输带宽持续升级，材料等级不断提高；高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，板厚进一步增厚，电路密度也更精细。

这些变化对 PCB 制造工艺要求大幅提高，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，加大了对公司高端产能的消耗。同时也使得产值提升，ASP 发生成倍甚至呈指数级别的增长。

二、互动交流环节具体情况如下：

1、上游原材料紧缺情况下，公司是否受影响？公司如何应对原材料涨价，是否有向下游传导？

答:公司对生产所需的关键原材料进行了积极的策略性备货和安全库存管理。作为多家关键原材料供应商的第一大客户，公司与主要原材料供应商均已建立了稳定的战略合作关系，原材料供应稳定。

目前公司高端产品所需主要原材料价格相对稳定，已量产的高端产品价格也较为稳定，新产品将结合原材料价

格走势及 PCB 工艺技术难度，与客户协商定价，相关工作正在按计划推进中。

原材料成本向产品定价传导存在合理周期，公司将通过优化供应链管理、技术创新及精细化运营等多种措施，积极对冲成本波动影响。

2、公司在ASIC领域客户布局进展如何？

答：公司持续加大市场攻坚与客户拓展力度，坚守“高端化、多元化”的布局原则，丰富客户结构，深度贴近客户需求，凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。

公司将巩固现有核心客户合作基础，深化与科技巨头的战略合作，持续扩大 GPU 加速卡、TPU 配套板等核心产品供应规模。目前公司在 ASIC 相关客户的业务进展顺利，未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。

3、公司下一代AI PCB关键产品的进度如何？

答：目前公司在手订单饱满，业务进展顺利，订单生产和交付均在正常履行中。公司目前在大客户和 ASIC 客户新产品、新技术方面的布局进展顺利，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒。

公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全力配合新产品的研发及量产工作。具体产品的量产时间节点将结合技术研发进度与客户需求综合确定。

4、公司加大资本开支布局高端 PCB 产能，是否有充足的需求支撑？

答：随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI 算力、AI 服务器的需求迅速增长，对 PCB 的需求量大且要求高，为行业未来的持续增长提供了强有力的支撑，未来 AI PCB 是整个 PCB 行业最具确定性的增长细分方向。

从行业发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是公司产品价值量、产值能力在不断提升。

从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。目前，公司的扩产节奏正在加速推进，在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备，当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。

5、公司从新建工厂到产能释放需要的时间较长，具体的节奏是什么样的？公司新建的工厂准备好后，良率的提升是否也需要较长时间？

答：新建厂房需经历厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程。从时间进度来看，国内工厂的建设与设备安装调试大约需要 1 年时间准备，海外工厂则需要更长时间。

新建工厂完成投产后，良率整体提升速度相对较快，主要得益于公司已具备成熟、稳定的生产工艺体系与质量管控标准，并采用成熟可靠的技术方案与设备配置。同时，公司派驻经验丰富的工艺及生产工程师、管理团队进驻新工厂，快速将成熟生产经验复制到新产线；原有的成熟产线也提前培养储备人员，承接已有项目。以此有效缩短良率爬坡周期，尽快实现稳定量产与目标良率水平。

6、泰国工厂产能及运营情况如何？

答：公司正在全力以赴推进扩产，当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。公司泰国工厂 A1 栋一期升级改造已于 2025 年 3 月完成，目前产能利用率处于良好水平；A1 栋二期高端产能已顺利通过多个客户的审厂认证工作，开始生产 AI 产品的验证板；泰国 A2 栋厂房已于近期完成主体封顶仪式，新建厂房需经历厂房装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程，公司对后续的生产经营及效益实现充满信心。

在运营方面，公司将充分发挥总部的人才、技术、品质、客户等优势全方面赋能海外生产基地，将惠州总部的核心竞争力以制度化、标准化方式输出至海外工厂，实现海内外基地间的强大协同及海外生产基地的高效运营。

目前泰国工厂的关键管理岗位和核心技术岗位，由惠州总部选派经验丰富的骨干人员派驻，将总部的管理理念、流程标准和工艺经验注入海外日常运营中。泰国生产基地已经部署与总部相同的生产管理系统，在计划排产、物料管理、质量控制等核心制造流程环节，复用总部的成

熟系统架构，确保从接单到交付的全链条信息流与总部保持同频互通，实现生产数据和运营指标的实时穿透可控。

7、如何看待公司后续毛利率等盈利能力的变化？

答：公司未来盈利能力有望保持平稳健康发展。一方面，随着高附加值、高毛利产品占比持续提升，产品结构不断优化，将对公司盈利能力形成持续的正向贡献；另一方面，公司短期盈利能力也会受到阶段性因素影响，例如公司为支撑长期发展与产能扩张带来的人员规模快速增加、研发项目持续投入、新建产线相关费用等阶段性支出的影响。

从人员情况来看，公司员工数量从 2024 年底的 1.3 万余人增长至 2025 年底接近 1.8 万人，主要是为未来产能释放与业务扩张提前进行人才储备。从研发情况来看，公司持续加大研发投入，聚焦核心产品技术升级、新工艺开发及新产品产业化落地，进一步提升自主研发能力与核心技术壁垒，为公司产能扩张、产品结构优化及长期可持续发展提供坚实技术支撑。

8、公司 mSAP 车间现在的运营情况如何？未来可能还有什么相关规划吗？

答：公司在惠州配置了 mSAP 车间，该产能目前用于满足 1.6T 光模块的生产需求，当前在手订单饱满，产能利用率处于良好水平。

此外，公司正积极推进 CoWop 技术的研发及生产工作，该技术需同时具备高阶 HDI 和 mSAP 工艺能力，预计相关 PCB 产品价值量将有较大幅度提升。公司始终与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全

	<p>力配合新产品的研发及量产工作。</p> <p>9、CPO 技术是否会替代背板需求？其技术路线有何特点？</p> <p>答：CPO 技术不会全面替代背板需求，其仅在特定方案或场景使用，且造价较高，背板市场总量会进一步增长。CPO 技术路线并非往短小轻薄方向，而是沿通信板方向，是厚板、大板、高阶高层方案。</p> <p>在 CPO 技术演进中，原本分散的可插拔部件更趋于集成化，部分传输功能可能集成到芯片内，PCB 在原有高电性能、稳定性、可靠性基础上增加高精密线宽线距工艺，平整度要求、加工精度要求、复杂程度会进一步提高，材料方面也有创新突破，产品 ASP 会进一步提高。</p> <p>10、请问公司有陶瓷基板方面的布局吗？</p> <p>答：公司凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，已深度参与国际头部大客户新产品预研，提前 2-3 年开展相关技术开发储备，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户。</p> <p>公司始终与客户保持密切沟通，全力配合新产品的研发相关工作。具体产品的量产时间节点将结合技术研发进度与客户需求综合确定。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年05月15日</p>